エレクトロニクス

ファイナルフィニッシュ

OSP – 水溶性プリフラックス

OSP - Organic Solderability Preservative

ENTEK® PLUS HT
プロセスは、PWB製造工程において使用される耐熱性の水溶性プリフラックス（OSP）です。鉛フリーはんだの高温及び複数回実装に対して、優れたはんだ濡れ性を有しています。

ENTEK® PLUS HT プロセスは以下の特徴を有しています。

- 複数回リフローやホールドタイム間の酸化を防止するための厚い防錆皮膜を生成します。
- 浴のコントロールで0.2～0.6μmの厚みの皮膜を得ることが出来ます。
- 皮膜は、より高い熱分解温度を有します。
- 銅とのみ化学結合するので、ENIGとの混在回路においても使用可能です。
- マクダーミッド・エンソンが推奨する梱包方法と保管方法であれば12ヶ月間のシェルフライフを実現出来ます。
- リフロー後の接触抵抗が低いため、インサーキットテストの歩留まりが良好であり、効率が向上します。